Vakumpārklājumu tehnoloģija

Jānis Erdmanis, Arnis Katkēvičs

2015. gada 7. novembrī

Date Performed	Oktobris
Partners	Jānis Erdmanis, Arnis Katkevičs
Instructor	

1. Mērķis

Iepazīties ar virsmas uzklāšanas un vakuma tehnoloģijas pamatiem

2. Ievads

Dažādu thenoloģisku vai zinātnisku pētijumu veikšanai ir nepieciešami augsts vakums. Lai iegūtu vakumu izmanto vakumsūkņus, kuri raksturojās ar spēju aizvadīt tilpumu kameras vides laika vienībā. Pretstatā tam dēļ spiediena starpības caur blīvēm, metāla porām, sūkņa atveres kamerā ieplūst apkārtējās vides gaiss, tādēļ spiediena vērtība ilgstušā sūkņa darbības režīmā tiecās uz galīgu vērtību. Šo galīgo vērtību sauc par robežspiedienu, kas industrijā tiek definēts, kā speidiena vērtība kura 1h laikā nemainās par 10%.

Izotermiskos apstākļos daļiņu plūsmu varam definēt, kā

$$Q = \frac{d(pV)}{dt} = p\frac{dV}{dt} + V\frac{dp}{dt} \tag{1}$$

jo pēc Klapeirona vienādojuma $dm/dt = \mu Q/RT$. Šajā vienādojumā par tilpuma izmaiņu laikā mēs uzskatām sūkņa virzuļa tilpuma izmaiņu, jo processu šajā brīdī uzskatām par kvazistatisku. Tā kā šo tilpuma izmaiņu laikā pie virzuļa nosaka tikai sūkņa darbības parametri tad mēs ievedam lielumu:

$$S_x = \left(\frac{dV}{dt}\right)_{A,p} \tag{2}$$

ko saucam par gāzes apjomu, kas izplūst caur šķērsgriezumu A ar spiedienu p laika vienībā jeb sūkņēšanas ātrumu.

Gadījumā, kad starp sūkni un kameru atrodās caurule gaisa viskozitātes dēļ sūknēšanas ātrums no kameras kļūst mazāks S_{eff} . No tā, ka gāze caurulē neuzkrājās $S_{eff}p_{in}=Q=S_xp_x$ un plūsma laminārā gadījumā raksturojās ar $Q=U(p_{in}-p_x)$, tad varam iegūt efektīvais atsūknēšanas ātrums ir

$$S_{eff} = \frac{S_x U}{S_x + U} \tag{3}$$

kas ar teču lielumu nosaka kamerā iegūstamo robežspiedienu, jo tad dp/dt=0

$$p_r = Q_t / S_{eff} \tag{4}$$

Teču lielumu Q_t kamerā varam iegūt, ja sūkni apstādinam jeb dV/dt=0, kas pēc eq. (1) un papildus iepludinam zināmu daudzumu gāzes Q_g

$$Q_g + Q_t = V \frac{dp}{dt} \tag{5}$$

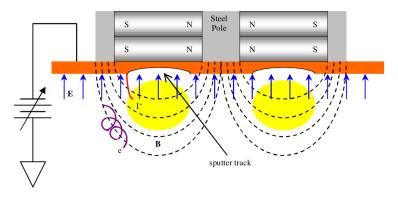
Šo lielumu tālak varam izmantot, lai novērtētu efektīvo atsūknēšanas ātrumu, ja papildus tecēm piepludinām argonu atsūknēšanas laikā

$$S_{eff} = \frac{Q_t + Q_g}{p} \tag{6}$$

Šī eksperimentālā atkarība var būt noderīga, lai piemēram novērtētu cik lielas teces kamerai izveidojušās zinot robežspiedienu.

2.1. Mirdzizlāde

Magnetrons ir ierīce, kura ar elektriskā lauka palīdzību jonizē inertu gāzi, kura palīdz iztvaicēt tai priekšā esošo metālu. Tipiska magnetrona shēma parādīta fig. 3, kur elektriskais lauks paātrina Ar^+ jonus uz mērķi, magnētiskais nodrošina elektronu ieslazdošanu tādēļādi samazinot nepiciešamās strāvas iztvaicēšanas veikšanai. Daļa no



1. att. Tipiska magnetrona shēma

elektroniem tomēr izkļūst no magnētiskā slazda un veido strāvu, kura būs atkarīga no sprieguma, spiediena, izmantotās inertās gāzes.

Ja šī magnerona tuvumā novietojam paraugu, kura potenciāls ir pozitīvs attiecībā pret magnetronu, tad uz paraugu sāks plūst no magnetrona magnētiskā slazda izkļuvušie elektroni un neitrālie metāla atomi. Tā kā neitrālie atomi var izšauties no virsmas uz jebkuru patvaļīgu virzienu, tad izšautā intensitāte no magnetrona pakļauļās Lambēra likumam jeb pēc kosinusa likuma.

Ja paraugs ir tuvu magnetronam, tad lielākā daļa no izšautajiem metāla atomiem kondensējās. Tādā gadījumā varam apskatīt cik mētāla atomus varam izšaut uz paraugu ar vienu elektronu. Elektronu daudzums ir $N_e=It/e$, bet no substrāta kondensētā tilpuma metāla atomi ir $N_{met}=\rho V N_A/\mu$ no kā:

$$\frac{N_{met}}{N_e} = \frac{\rho V N_A / \mu}{It/e} \tag{7}$$

No šīs attiecības, tad varam arī novērtēt darbu, kas nepieciešams, lai ar šādu processu metāla atomi no mērķa izrautu

$$A = Ue \frac{N_e}{N_{met}} \tag{8}$$

ko var salīdzināt ar atoma virsmas enerģiju dotajam metāla mērķim.

3. Darba piederumi

- Vakumkamera ar tilpumu $1m^3$ ar sasniedzamo robežspiedienu $1\cdot 10^{-5} Tori$
- Priekšvakuma sūknis
- Turbomolekulārais sūknis T 1600 (Oerlicon Leybold Vacuum)
- Vakummetrs
- Gāzu iepludināšanas ierīce
- Mirdzizlādei voltmetrs, ampērmetrs, magnetrons
- Paraugs ar virsmas izmēriem $2 \cdot 5 \ cm$

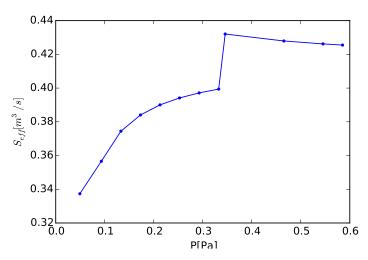
4. Darba uzdevumi

- Vakumkameras robežspiediena noteikšana
- Kameras teču lielumu noteikšana
- Vakumkameras efektīvās atsūknēšanas ātruma noteikšana
- Mirdzizlādes voltampērliknes uzņemšana un paraugu apstrāde

5. Dati un apstrāde

Row	$p[Tori\cdot 10^{-5}]$	Q[sscm]	P[Pa]	QSi	$S_{eff}[cm^3/s]$
1	37.0	10.0	0.04921	0.0166	0.33733
2	70.0	20.0	0.0931	0.0332	0.356606
3	100.0	30.0	0.133	0.0498	0.374436
4	130.0	40.0	0.1729	0.0664	0.384037
5	160.0	50.0	0.2128	0.083	0.390038
6	190.0	60.0	0.2527	0.0996	0.394143
7	220.0	70.0	0.2926	0.1162	0.397129
8	250.0	80.0	0.3325	0.1328	0.399398
9	260.0	90.0	0.3458	0.1494	0.432042
10	350.0	120.0	0.4655	0.1992	0.427927
11	410.0	140.0	0.5453	0.2324	0.426187
12	440.0	150.0	0.5852	0.249	0.425496

2. tabula. Atsūknēšanas ātruma atkarība no spiediena



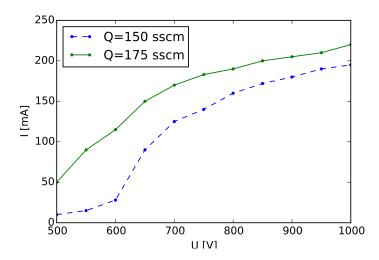
 $2.~{\rm att.}~{\rm Efekt\bar{i}v\bar{a}}~{\rm ats\bar{u}kn\bar{e}\check{s}anas}~{\bar{a}truma}~{\rm atkar\bar{i}ba}$ no spiediena

Row	t[s]	$p[Tori\cdot 10^{-5}]$	p[Pa]	$Q[Pa\cdot m^3/s]$
1	30.0	12.0	0.01596	0.000524552
2	60.0	26.0	0.03458	0.000568265
3	90.0	39.0	0.05187	0.000568265
4	120.0	53.0	0.07049	0.000579193
5	150.0	68.0	0.09044	0.000594492
6	180.0	81.0	0.10773	0.000590121
7	210.0	96.0	0.12768	0.000599488
8	240.0	110.0	0.1463	0.000601049
9	270.0	130.0	0.1729	0.000631405

4. tabula. Kameras teču līmeņa noteikšana

Row	U[V]	$I_{Q=150}[mA]$	$I_{Q=175}[mA]$
1	500	10	50
2	550	15	90
3	600	28	115
4	650	90	150
5	700	125	170
6	750	140	183
7	800	160	190
8	850	172	200
9	900	180	205
10	950	190	210
11	1000	195	220

6. tabula. Mirdzizlādes pētīšana



3. att. Mirdzizlādes voltampērliknes pie dažādiem Ar plūsmas ātrumiem

5.1. Rezultāti

Noteikts kameras robešspiediens $p_r=1.7\cdot 10^{-5}Tori=2.3mPa$ un teču lielums $Q_t=584\pm 30Pa\cdot cm^3/s=0.352\pm 0.018sscm$. Pie robežspiediena tādēļ efektīvais sūknēšanas ātrums $S_{eff}=Q_t/p_r=0.254m^3/s$.

Putinot paraugu 2minpie sprieguma U=700V un I=125mA ieguvām tā biezumu 400nm. Tas nozīmē, ka lai iegūtu vienu Cu atomu uz metāla tika patērēti 2.77e jeb 1.943keV

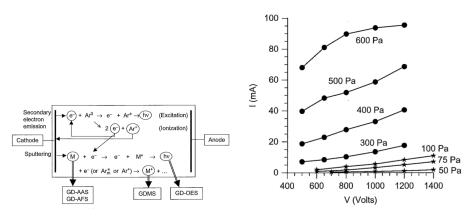
6. Secinājumi

Kameras efektīvā atsūknēšanas ātruma noteikšanai pie dažādiem spiedieniem izmantojām argona gāzi, kura ar nomērāmu plūsmu ieplūda kamerā. Plūsmu izvēlējāmies vairākas kārtas lielāku nekā kameras teces, tādēļ to varēja neņemt vērā. Sūkņa efektīvā atsūknēšanas ātruma atkarība redzama attēlā fig. 2.

Visā mērīšanas diapazonā sūknēšanas efektivitāte ir mazāka par dokumentācijā doto $1.5m^3/s$ turbomolekulārajam sūknim, kur starpība radusies galvenokārt dēļ mazās cauruļu vadāmības. Pie lieliem spiedieniem efektivitāte samazinās, jo starp turbomolekulārā sūkņa lāpstiņām gāzes molekulas paspēj sadursmju rezultātā izlīdzināt izotropiski ar lāpstiņu triecienu iedoto impulsu. To apstiprina brīvā ceļa garuma tuvošanās ierīces izmēriem ap 10cm pie $p=1\cdot 10^{-4}Tori$. Pie maziem spiedieniem jeb P<0.3Pa efektivitāte samazinās dēļ atpakaļ ejošās plūsmas jeb varbūtība, ka molekula no izejas atgriezīsies ieejā kļūst salīdzināma ar varbūtību molekulai no ieejas nonākt izejā.

Lai novērtētu optimālus parametrus virsmas putināšanai, uzņēmām voltampēr raskturlīknes pie divām dažādām argona plūsmām (jeb spiedieniem, jo sūknis bija ieslēgts), kuras redzamas attēlā fig. 3. Plazmas aizdedzināšanai ir nepieciešama minimālā potenciāla starpība, ko redzam pie 600V un 150sscm, bet pie 175scm aizdedzināšanas vērtība ir pirms 500V. Šim efektam modeli ir izveidojis [1], kurš parāda, ka eksistē tāds spiediens pie kura jonizācijai nepieciešamais spriegums ir minimāls. Pie lielāka sprieguma savukārt elektrona slazdojošais efekts pie mērķa magnētiskā lauka kļūst salīdzinoši mazāks tādēļ pieaug strāva.

Lai izprastu līkņu atkarības formu izmantoju [3] atrodamo modeli ar nomodelētām raskturlīknēm Ar pie dažādiem kameras spiedieniem.



Vizuāli redzam labu sakritību pie Ar gāzes spiediena 600Pa, bet pie mazākiem spiedieniem šī atkarība kļūst citādāka. Pie Ar plūsmas 150sscm spiediens kamerā ir tikai 0.5Pa, bet jau novērojams piesātināšanās efekts. Tā kā temperatūra sadalījums gāzē lielā mērā atkarīgs no siltumapmaiņas procesiem, kuri jāiestata modelī ar roku, tad šīs līknes varam izmantot kvaletatīvi, lai skaidrotu plazmā notieksošos procesus.

Pateicoties elektronu gāzēs koncentrācijai N_e un mijiedarbībai ar argona gāzi pēc reakcijas $Ar^0+e^-\to Ar^++2e^-$ ir spēkā elektronu ģenerēšana pēc formulas [1, eq (20.44)]

$$\frac{dN_e}{dt} = \alpha N_e \qquad \qquad \alpha = N_{Ar} \langle v \sigma_{ion} \rangle / w_e \qquad (9)$$

kur w_e ir elektronu vidējais pārvietošanās ātrums. Parasti elektronu kinētiskā enerģija ievērojami pārsniedz argona atoma jonizācijas enerģiju un tad var pieņemt, ka jonizācijas šķērsgriezumam ir eksponenciāls raskturs $\sigma \propto \exp(-(E_{el}-E_{ion})/k_BT)$ tad pēc [1, eq (20.54)] iegūst, ka raksturlīknei ir jābūt $I \propto U^2$. Šādu ainu mēs redzam pie maziem spiedieniem modelētajām raksturlīknēm iepriekšējā grafikā.

Lai raksturotu piesātinājumu, ir jāņem vērā arī, ka elektrons saduroties ar argonu var arī to tikai atstāt ierosinātā stāvoklī jeb $Ar^0=e^-\to Ar^*+e^-$. Ši procesa rezultātā elektrons daļu savas kinētiskās enerģijas ir zaudējis, bet ierosinātais argons sabrūk atdodot fotonu $Ar^*\to\gamma+Ar^0$. Tas nozīmē, ka elektronu vidējais ātrums tiek ierobežots un tādēļ to spēja ģenerēt jaunus elektronus pēc argona sadursmēm. Šis putināšanai ir nevēlams efekts, jo netiek uzģenerēti Ar^+ joni, kuri tvaicē katoda metālu.

Putināšanai izvēloties U=700V un 150sscm, kam ir mazāki zudumi, 2min ieguvām kārtiņu ar biezumu 400nm. No strāvu šajā procesā var noteikt nepieciešamo darbu, kas patērēts vara atomu pārnesot no mērķa, kas vienāds ar 1.94keV. Salīdzinot šo vērtību ar virsmas enerģiju vara atomam 3.48eV [2] un Ar jonizācijas enerģiju 15eV varam secināt, ka liela daļa enerģijas ir izmanto neefektīvi.

Literatūras saraksts

- [1] Von Engel, A., & Singer, S. F. (1956). Ionized Gases. Physics Today, 9(6), 26. doi:10.1063/1.3059995
- [2] Kudriavtsev, Y., Villegas, A., Godines, A., & Asomoza, R. (2005). Calculation of the surface binding energy for ion sputtered particles. Applied Surface Science, 239(3-4), 273–278. doi:10.1016/j.apsusc.2004.06.014
- [3] Vogl, J. (2011). Diane Beauchemin and Dwight E. Matthews (Eds.): The encyclopedia of mass spectrometry, Volume 5: Elemental and isotope ratio mass spectrometry. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 401(2), 573–574. doi:10.1007/s00216-011-5106-0